

Branchenführer Elektronik-Fertigung

19. Auflage 2018/2019

als Buch und im Internet

Eugen G. Leuze Verlag KG
Karlstraße 4

D-88348 Bad Saulgau

Eintragsformular für

- ➔ **Bestücker** **Seite 3**
- ➔ **Leiterplattenhersteller und -vertriebsfirmen** **Seite 4/5**
- ➔ **Zulieferer und Dienstleister** **ab Seite 6**
- Preise Firmeneintrag / Inserat** **Seite 2**

Hiermit bestellen wir den folgenden Eintrag:

Datum Firmenstempel und Unterschrift

Ansprechpartner für evtl. Rückfragen

VAT-No

Bitte umgehend zurücksenden

A	Firma:	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
	Sortierung:	<input style="width: 30%;" type="text"/>	<small>Stichwort für alphabetische Sortierung. Zum Beispiel: Firmierung: Eugen G. Leuze Verlag Sortierung: Leuze Verlag</small>			
ANSCHRIFT:						
	Straße:	<input style="width: 30%;" type="text"/>	PLZ:	<input style="width: 10%;" type="text"/>	Ort:	<input style="width: 30%;" type="text"/>
	Staat:	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
	Telefon:	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
	Telefax:	<input style="width: 30%;" type="text"/>	Internet:	<input style="width: 60%;" type="text"/>		
	Mobiltel:	<input style="width: 30%;" type="text"/>	E-Mail:	<input style="width: 60%;" type="text"/>		
B	Ansprechpartner für Vertrieb:	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
	Ansprechpartner für Technik:	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
C	Handelsnamen, Produkte:	<small>Beispiele: PHOTOPosit® – fotolithografische Produkte . . .</small>				
		<input style="width: 100%;" type="text"/>				
		<input style="width: 100%;" type="text"/>				
	Zusätzliche Angaben:	<small>Beispiele: Kundenberatung, Service, Qualitätsprüfungen, Mitgliedschaften, Fachbetriebszeichen usw.</small>				
		<input style="width: 100%;" type="text"/>				
		<input style="width: 100%;" type="text"/>				
E	Filial- und Tochterbetriebe:	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
		<input style="width: 100%;" type="text"/>				
		<input style="width: 100%;" type="text"/>				
F	Eintrag auf Formular	<input type="checkbox"/>	Anzeigenbestellung mit Inseratformular, Seite 2			

NEU

Ihr Logo beim Adresseintrag – für mehr Aufmerksamkeit und Wiedererkennung.

Logo beim Adresseintrag

Bitte schicken Sie nach Auftragserteilung eine separate Datei im Vektorformat (PDF, AI, EPS, o.ä.). Farbe: Schwarz/Weiss

Ja Nein

Sollte der Platz für Ihre Eintragungen nicht ausreichen, benutzen Sie bitte ein getrenntes Blatt!

Preise

Preise für Firmeneintrag (im Buch und im Internet)

- Einträge unter:**
- A** € 59,- incl. 1 Belegexemplar
 - B** kostenfrei
 - C** € 15,- pro Zeile à 30 Buchstaben
 - D** € 98,- Logo beim Adresseintrag
 - E** € 15,- pro Zeile à 30 Buchstaben
 - F** 10 Einträge im Formular sind kostenfrei,
jeder weitere Eintrag wird mit € 5,- berechnet
- Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

Preise für Werbeanzeigen

Außer unserem Eintrag im Adressenverzeichnis wünschen wir die Veröffentlichung eines Inserates in folgender Größe (Grundpreis schwarz/weiß)

- | | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1/4 Seite | 135 mm Breite, | 50 mm Höhe | € 295,- |
| <input type="checkbox"/> | Sondergröße | 85 mm Breite, | 125 mm Höhe | € 530,- |
| <input type="checkbox"/> | 1/2 Seite | 135 mm Breite, | 100 mm Höhe | € 590,- |
| <input type="checkbox"/> | 1/1 Seite | 135 mm Breite, | 200 mm Höhe | € 1180,- |

- Farbanzeigen:**
- Zuschlag pro Farbe bei Euroskala € 160,-
 - Zuschlag pro Sonderfarbe € 220,-

- Anschnittzuschlag:** 10 % des Grundpreises

- Vorlagen:**
- Vorlage oder Anzeigentext liegen bei
 - Vorlage oder Anzeigentext werden nachgereicht
 - Entnehmen Sie unsere Anzeige aus den Fachzeitschriften
„PLUS“ Heft Nr. _____ unverändert
„Galvanotechnik“ Heft Nr. _____ unverändert

Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

Datum

Ort

Firmenstempel

Unterschrift

Tragen Sie bitte dort, wo freie Linien sind, die Stichworte ein, die für Sie zutreffen – es können bei einem Eintrag auch mehrere sein.

10 Bestückung

10/100 Beschaffung

- 10/101 Beschaffung von elektronischen Bauteilen
- 10/102 Beschaffung von mechanischen Bauteilen
- 10/103 Beschaffung von Frontplatten
- 10/104 Beschaffung von Gehäusen
- 10/105 Beschaffung von Leiterplatten

10/200 Herstellung von Bauteilen

- 10/201 Herstellung von elektronischen Bauteilen:

- 10/202 Herstellung von mechanischen Bauteilen und Gehäusen:

10/300 Entwicklung

- 10/301 Entwicklung kundenspezifischer Elektronik mit Schwerpunkt:

10/400 Konstruktion

- 10/401 Konstruktion von mechanischen Teilen:

10/500 Service und Layout

- 10/501 Layouterstellung mit dem System:

- 10/502 CAD, Entflechtungsservice
- 10/503 Designberatung
- 10/504 Reprotechnik
- 10/505 Bauteilebeschaffung
- 10/506 Electronic Design
- 10/507 Entwicklung von Geräten, Sondermaschinen und Apparaten
- 10/508 Kundenspezifische Hard- und Software-Entwicklung
- 10/509 BGA/CSP/Flip-Chip-Bestückung und Reparatur
- 10/510 Rapid-Prototyping 3D-Dienste
- 10/511 Programmierung von PLDs, EPROMs und Mikroprozessoren
- 10/512 Optischer Test von Flachbaugruppen
- 10/513 Röntgenprüfung
- 10/514 Solder-Ball-Inspektion
- 10/515 Kabelkonfektionierung inkl. Funktionstest
- 10/516 Reparatur defekter Elektronik-Baugruppen
- 10/517 CAM-Datenaufbereitungsservice
- 10/518 CNC-Programmieren
- 10/519 Scannen/Digitalisieren
- 10/520 Datenkonvertierung
- 10/521 Fotoplotservice
- 10/522 EAN-Filmmaster
- 10/523 Photomasken > 5 x 5 inch
- 10/524 Photomasken aus Glas bis 32 x 24 inch
- 10/525 Layout-Umsetzungen für Prüfadapter
- 10/526 Dosierautomaten
- 10/527 Abdeckung für Chips

10/600 Bestückung

- 10/601 Bestücken mit SMD und konventionellen Bauteilen
- 10/603 Bestücken von Fine-Pitch-Bauteilen:

- 10/604 Bestücken von COB
- 10/605 Wellenlöten
- 10/606 Reflowlöten
- 10/607 Selektivlöten
- 10/608 Bleifreies Löten
- 10/609 Sonderlöttechnik:

- 10/610 Prototypen und Klein- und mittlere Serien
- 10/611 Großserien
- 10/612 Eilservice

10/700 Montage

- 10/701 Montage von Baugruppen
- 10/702 Fertigung kompletter Geräte
- 10/703 Rückwandverdrahtung in Einpresstechnik
- 10/704 Einpresstechnik
- 10/705 Vergießen von elektronischen Baugruppen

10/800 Test

- 10/801 Testengineering
- 10/802 Visuelle Kontrolle
- 10/803 Automatische optische Kontrolle
- 10/804 Incircuittest
- 10/805 Funktionstest
- 10/806 Spezialtest:

- 10/807 Prüfprotokolle:

- 10/808 Prüfmittelbau
- 10/809 Zertifiziert nach:

10/900 EDV und Sonstiges

- 10/901 PPS-System:

- 10/902 Datentransfer:

- 10/903 Produkthaftungsversicherung
- 10/904 Sonstige Dienstleistungen:

11 Standard-Leiterplatten

Standard-Leiterplatten sind:

Basismaterial	FR4
Leiterplattenstärke	1,0 - 2,4 mm
Leiterbahnbreiten und -abstände	> 250 µm
Galvanischer Kupferaufbau	25 µm
kleinster Bohrungsenddurchmesser	0,2 mm
mit Lötstopmmaske	Fotosensitive Lackbeschichtung
Oberfläche	Heißluftverzinneung
Kennzeichnungsdruck	Siebdruck
Kontur	gefräst
Prüfungen	elektrisch

11/000 Leiterplattenhersteller und/oder -vertrieb

- 11/010 Leiterplattenhersteller
- 11/020 Leiterplattenvertrieb

11/100 Leiterplattenarten

- 11/104 Mehrlagenschaltungen (Multilayer) bis 8 Lagen
- 11/107 Mehrlagenschaltungen (Multilayer) bis 12 Lagen
- 11/108 Mehrlagenschaltungen (Multilayer) bis 16 Lagen
- 11/109 Mehrlagenschaltungen (Multilayer) bis 24 Lagen
- 11/110 Mehrlagenschaltungen (Multilayer) bis 32 Lagen
- 11/111 Mehrlagenschaltungen (Multilayer) bis 48 Lagen
- 11/120 Doppelseitige, nicht durchmetallisierte Leiterplatten
- 11/130 Durchmetallisierte Leiterplatten
- 11/140 Multilayer
- 11/150 Einseitige, nicht durchmetallisierte Leiterplatten

11/200 Maximale Formate

- 11/210 Maximale Größe der Zweilagenschaltung
_____ mm x _____ mm
- 11/220 Maximale Größe der Multilayerschaltung
_____ mm x _____ mm

11/300 Standard-Lieferzeiten für Serien (bezogen auf Euroformat 100 x 160 mm)

- 11/310 Standard-Lieferzeiten bis 100 Stück _____ Arbeitstage
- 11/320 Standard-Lieferzeiten bis 1000 Stück _____ Arbeitstage
- 11/330 Standard-Lieferzeiten bis 5000 Stück _____ Arbeitstage
- 11/340 Standard-Lieferzeiten über 5000 Stück _____ Arbeitstage
- 11/350 Fertigungsschwerpunkt Stückzahl _____

12 Zusätzliche Leistungen

12/100 Mehrlagenschaltungen (Multilayer)

- 12/101 Mehrlagenschaltungen (Multilayer) bis 4 Lagen
- 12/104 Mehrlagenschaltungen (Multilayer) bis 8 Lagen
- 12/105 Multilayer bis 10 Lagen
- 12/107 Multilayer bis 12 Lagen
- 12/108 Multilayer bis 16 Lagen
- 12/111 Multilayer bis 20 Lagen
- 12/121 Multilayer über 20 Lagen
- 12/131 Multilayer mit definierter Leitungsimpedanz
- 12/132 Multilayer, Bohrungen der Innenlagen partiell durchmetallisiert (burried holes)
- 12/133 Mehrlagenschaltungen mit Sacklöchern (blind holes)
- 12/134 Multilayer mit Photo-Via
- 12/135 Multilayer mit Laser-Via
- 12/136 Multilayer mit Micro-Via
- 12/141 Metallkernmultilayer
- 12/151 Kevlarmultilayer
- 12/152 Aramidmultilayer

- 12/153 Multilayer mit Dicken unter 0,8 mm
- 12/154 Flexboards
- 12/155 Kupfer-Invar-Kupfer-Multilayer
- 12/156 Kupfer-Molybdän-Kupfer-Multilayer
- 12/157 Kupfer-Kohlefaser-Kupfer-Multilayer
- 12/158 Teflonmultilayer
- 12/159 Hybridmultilayer
- 12/160 Starr-flex-Multilayer
- 12/161 Keramische Multilayer

12/200 Leiterplatten-Feinheitsgrade

- 12/209 Leiterbahnbreiten und -abstände > 200 µm
- 12/211 Leiterbahnbreiten und -abstände 150 µm bis 200 µm
- 12/221 Leiterbahnbreiten und -abstände 80 µm bis 150 µm
- 12/231 Leiterbahnbreiten und -abstände < 80 µm
- 12/232 Leiterbahnbreiten und -abstände < 50 µm

12/300 Sondertypen

- 12/311 Flexible einseitige und doppelseitige Schaltungen
- 12/312 Flexible und starr-flex Multilayerschaltungen
- 12/321 Leiterplatten für Chip-on-board-Technik
- 12/331 Teflonschaltungen
- 12/341 Schaltungen nach MIL-Anforderungen
- 12/351 Dünnschichtschaltungen
- 12/352 Hybridschaltungen
- 12/361 Dreidimensionale Leiterplatten
- 12/363 Direct Copper Bonding-Technologie
- 12/364 Schaltungen aus Kupfer/Keramik-Verbundmaterial
- 12/365 Leiterplatten mit Aufverkupferung für Hochstromtechnik
- 12/366 Biegbare Leiterplatten
- 12/367 Leiterplatten mit Silber-Polymer-Durchkontaktierung
- 12/368 PAD-Layer-Technik
- 12/369 Leiterplatten auf IMS
- 12/371 Heatsink-Leiterplatten
- 12/372 Leiterplatten mit Laserdirektbelichtungs-Technik
- 12/373 Leiterplatten in Landless-Design
- 12/374 Burried Jumper-Technologie
- 12/375 Flip-Chip-Technik
- 12/376 Alu-Leiterplatten
- 12/377 Leiterplatten aus Aramidmaterial
- 12/378 Dycorate-Leiterplatten
- 12/379 Direktbelichtete Leiterplatten
- 12/380 Leiterplatten aus FR 5
- 12/381 Leiterplatten aus G 200
- 12/382 Gedruckte Widerstände
- 12/390 SIMOV/HDI/SBU-Leiterplatten
- 12/391 Leiterplatten mit Kupferdicke ≤ 400 µm
- 12/392 TWIN flex
- 12/393 Starr-flex
- 12/394 Elektro-optische Leiterplatten

12/400 Oberflächenausführungen

- 12/411 SMD-Lötdepot
- 12/421 Reinkupfertechnik
- 12/431 Nickeltechnik
- 12/432 Chem. Zinn oder chem. Zinn/Blei
- 12/433 Heißluftverzinneung
- 12/434 Chem. Nickel/Palladium/Gold
- 12/435 Oberfläche verbleit
- 12/442 Kammvergoldung
- 12/443 Partielle Schaltervergoldung
- 12/444 Bondgold
- 12/445 Sonstige Edelmetallaufgaben
- 12/446 Palladium
- 12/450 Alpha Level
- 12/451 Sonstige Oberflächenausführungen
- 12/452 Organische Kupferpassivierungen

- 12/453 Hot Air Leveling, bleifrei
- 12/462 Karbondruck und Kontakt
- 12/463 Galvanisch Reinzinn
- 12/465 PlanarTec (SMD-Verzinnung)
- 12/466 Gedruckte Potentiometer
- 12/467 KoPAD-Lötdepot
- 12/468 Ball Grid Array, BGA
- 12/470 Straschu-High-PAD
- 12/481 OSP Umwelt ISO 14001 zertifiziert
- 12/485 Planar-HAL horizontal DS
- 12/490 Entek-Plus
- 12/491 Chemisches Silber

12/500 Lötstoppsmasken-Zusatzdrucke

- 12/511 Lötstoppsmasken mit fotosensitivem Flüssigresist
- 12/521 Lötstoppsmasken mit fotosensitivem Festresist
- 12/541 Lötdeckmaske abziehbar
- 12/551 Leiterplatten mit Graphitleitlack
- 12/561 Leiterplatten mit Silberleitpaste
- 12/571 Leiterplatten mit Lötpastendruck
- 12/572 Positionsdruck mit fotosensitivem Flüssigresist
- 12/581 Fotosensible Flüssigresiste in allen Farben

12/600 Konturbearbeitung

- 12/611 Kontur geritzt (für Nutzenbestückung)
- 12/621 Kerbfräsen
- 12/622 Tiefenfräsen
- 12/631 Kontur gestanzt
- 12/632 Warmstanzen
- 12/633 Jump Scoring

12/700 Vorlagenerstellung

- 12/721 Vorlagenerstellung mit Reprotechnik
- 12/722 Vorlagenerstellung mit CAM, CAM-Datenaufbereitung
- 12/723 Digitalisieren, Revektorisieren, Vorlagenübernahme in CAM mittels Scannen
- 12/726 Datenübernahme mit Datenfernübertragung
- 12/727 Laserplotten
- 12/728 Fotoplotservice
- 12/729 Datenkonvertierung

12/800 Qualitätssicherung, Prüfungen

- 12/810 Qualitätssicherung
- 12/811 Zertifiziert nach DIN ISO 9001 (EN 29001)
- 12/812 Zertifiziert nach DIN ISO 9002 (EN 29002)
- 12/813 Zertifiziert nach DIN ISO 9003 (EN 29003)
- 12/814 UL-Zulassung
- 12/815 Zertifiziert nach QS 9000
- 12/816 MIL-Zulassung
- 12/818 CNET-Freigabe
- 12/819 Sonstige Zulassungen _____

12/820 Optische/visuelle Leiterplattenprüfung

- 12/821 Automatisch-optische Inspektion
- 12/822 Automatisch-optische Inspektion gegen CAD/CAM-Daten
- 12/823 Computerunterstützte visuelle Prüfung

12/830 Elektrische Prüfung von Leiterplatten

- 12/831 Elektrische Prüfung von Standard-Leiterplatten
- 12/832 Elektrische Prüfung von SMD-Leiterplatten
- 12/833 Elektrische Prüfung gegen CAD/CAM-Daten
- 12/834 Impedanzprüfung
- 12/835 Elektrische Prüfung von beidseitigen SMD-Leiterplatten
- 12/836 Translatortest
- 12/840 Elektrische Prüfung von Leiterplatten (Standard, SMD) beidseitig

12/900 Schnellservice für Muster und Prototypen

- 12/901 Musterdienst

12/910 Schnellservice für zweilagige Leiterplatten

- 12/911 ab 2 Tagen
- 12/912 ab 5 Tagen
- 12/913 ab 10 Tagen
- 12/914 Sonstiger Schnellservice Zweilagigen

12/920 Schnellservice für Multilayer

- 12/921 bis 3 Tage
- 12/922 ab 5 Tagen
- 12/923 ab 10 Tagen
- 12/924 ab 15 Tagen
- 12/925 Sonstiger Schnellservice Multilayer
- 12/930 Schnellservice für Flex- und Starr-flex-Leiterplatten
- 12/934 ab 4 Tagen
- 12/936 ab 6 Tagen

12/940 Schnellservice in allen Technologien

- 12/940 Schnellservice in allen Technologien
- 12/941 ab 1 Tag
- 12/942 Schnellservice für ein- und zweilagige flexible Leiterplatten

13 Sonderleistungen, Sonderprodukte

13/100 Ergänzende Dienstleistungen

- 13/101 Fotoplotservice
- 13/102 Leiterplattenreparatur
- 13/103 Geräte- und Anlagenbau
- 13/104 Schliffbilderstellung

13/200 Sonderprodukte

- 13/221 Alu-Frontplatten
- 13/231 Formätzteile
- 13/232 SMD-Lötpasten-Metallschablonen
- 13/241 Siebe und Schablonen für den Lötpastenauftrag
- 13/242 Gehäuseteile aus Metall oder Kunststoff
- 13/243 Gehäuse aus Kunststoff
- 13/244 Gehäuse aus Aluminium (Druckguss, Strangguss)
- 13/252 MID, spritzgegossene 3D-Leiterplatten
- 13/260 Chip Carrier
- 13/261 Elektrolumiszierende Frontfolien

13/300 Sonstige Sonderleistungen

- 13/311 Bedrucken von Geräteteilen
- 13/321 Galvanisieren von Geräteteilen
- 13/322 Vakuum-Metallisieren von Geräteteilen
- 13/331 Lackieren von Geräteteilen
- 13/341 Vergießen von elektronischen Baugruppen
- 13/342 Leiterplatten mit integrierten aktiven und passiven Bauteilen (AML[®])
- 13/343 Frontplatten mit integrierten Bauteilen

Neue Rubriken

Zulieferer und Dienstleister

**21 Basismaterialien,
Chemikalien, Hilfsstoffe,
Metalle, Werkzeuge****21/100 Basismaterialien**

- 21/101 Starre Basismaterialien und Prepregs aus FR4
- 21/102 Starre Basismaterialien und Prepregs aus Polyimid
- 21/103 Teflon-Basismaterialien
- 21/104 Flexible Basismaterialien
- 21/105 Fotobeschichtete Basismaterialien
- 21/106 Abdeck- und Isolierfolien
- 21/107 Kleber und Haftvermittler
- 21/108 Spezielle Basismaterialien und Sondermaterialien
- 21/109 FR2-VO Basismaterialien
- 21/110 Hartpapier-Basismaterialien
- 21/111 Semiflexible Basismaterialien
- 21/112 Composite-Basismaterialien
- 21/113 Starre Basismaterialien und Prepregs aus BT-Epoxyd
- 21/114 No flow prepregs
- 21/115 IMS (Insulated Metal Substrat)
- 21/116 Basismaterialien aramidverstärkt
- 21/117 Starre Basismaterialien und Prepregs aus FR5
- 21/118 Dünnlamine zur Multilayerherstellung
- 21/119 HF-Mikrowellensubstrate
- 21/121 CEM-3-Basismaterialien
- 21/122 Minilamination
- 21/124 Halogenfreies Basismaterialien

21/200 Chemikalien**21/210 Elektrolyte**

- 21/211 Kupfer-Elektrolyte
- 21/212 Blei-Elektrolyte
- 21/213 Zinn-Blei-Elektrolyte
- 21/214 Zinn-Elektrolyte
- 21/215 Edelmetall-Elektrolyte
- 21/216 Nickel-Elektrolyte
- 21/217 Sonder-Elektrolyte
- 21/218 Bleifreie Zinnlegierungen

**21/220 Stromlose Metallabscheidungen
und Oberflächenveredelungen**

- 21/221 Chemisch Kupfer
- 21/222 Chemisch Nickel
- 21/223 Andere stromlose Metallabscheidungsbad
- 21/224 Chemische Oberflächenveredelungen
- 21/225 Chemisch Gold
- 21/226 Chemisch Zinn
- 21/227 Organische Kupferkonservierungen
- 21/228 Chemisch Silber

21/230 Additive

- 21/231 Additive für Elektrolyte
- 21/232 Additive für chemische Metallisierungen

21/240 Prozesschemikalien

- 21/241 Ätzmittel
- 21/242 Foto-Resist-Stripper

- 21/243 Foto-Resist-Entwickler
- 21/244 Reiniger und Entfetter
- 21/245 Kupferoxidierchemikalien
- 21/246 Metallstripper
- 21/247 Edelmetallstripper
- 21/248 Aufheller
- 21/249 Desmear-Etchback-Chemikalien
- 21/250 Entschäumer
- 21/251 Organo-Antiox-Beschichtung für Kupfer
- 21/252 Kunststoffkonditionierer
- 21/253 Reiniger für Betriebswasser
- 21/254 Siebreinigungsmedien

21/270 Verbrauchskemikalien

- 21/271 Säuren
- 21/272 Laugen
- 21/273 Chemikalien zur Abwasserbehandlung
- 21/274 Wasserkonditionierer

21/280 Fluxe

- 21/281 Fluxmittel für Heißluftverzinneung
- 21/282 Fluxmittel zum IR-Umschmelzen
- 21/283 Fluxmittel für die Elektronik
- 21/284 Fluxmittel für Pb-freies Löten

21/290 Sonderchemikalien

- 21/291 Fotochemikalien für die Mikroelektronik
- 21/292 Reinigungsmittel für die Elektronik
- 21/293 Kupferpassivierung
- 21/294 Fluxentferner

21/300 Hilfsstoffe**21/310 Hilfsstoffe für die
mechanische Bearbeitung**

- 21/311 Bohrauflagen
- 21/312 Bohrunterlagen
- 21/313 Verstiftungsmittel

21/320 Filtermaterialien

- 21/321 Filterkerzen
- 21/322 Filtertextilien
- 21/323 Filterpapiere
- 21/324 Filterplatten für Kammerfilterpressen
- 21/325 Filtertücher für Kammerfilterpressen

21/330 Sonstige Hilfs- und Verbrauchsprodukte

- 21/331 Abklebeband
- 21/332 Schutzfolien
- 21/333 Schleif- und Poliermittel
- 21/334 Bürstwalzen
- 21/335 Reparaturmaterial für Leiterplatten
- 21/336 Hilfsmaterialien für das Verpressen von Multilayern
- 21/337 Hilfsmaterialien für den Siebdruck
- 21/338 Barcode-Etiketten
- 21/339 Produkte zur Vakuumverpressung
- 21/341 Presspolster für Multilayer-Fertigung
- 21/342 Reinigungsprodukte

21/400 Metalle

21/410 Anoden

- 21/411 Kupferanoden
- 21/412 Bleianoden
- 21/413 Zinnanoden
- 21/414 Zinn/Bleianoden
- 21/415 Edelmetallanoden
- 21/416 Titananoden

21/420 Metallfolien

- 21/421 Kupferfolien
- 21/422 Aluminiumfolien
- 21/423 CAC, Kupfer-Aluminium-Kupfer-Laminierfolien
- 21/425 CSC, Kupfer-Stahl-Kupfer Laminierfolien

21/430 Sondermetalle

- 21/431 Metalle für die Halbleitertechnik (hochrein)
- 21/432 Kolamine
- 21/433 Targets-Vakuumtechnik

21/440 Lote

- 21/441 Lot für Hot Air Leveling
- 21/442 Lot für Lötanlagen
- 21/443 Sonderlote
- 21/445 Lötpasten, Lötcremes
- 21/446 Lötdrähte
- 21/447 SMT-Lötpasten
- 21/448 Lötpasten für Pb-freies Löten

21/450 Metallpräparate

- 21/452 Leitpasten
- 21/453 Dickfilmpasten
- 21/454 Kleber und Sonstiges

21/500 Werkzeuge

- 21/511 Bohrer und Fräser
- 21/512 Bohr- und Frässpindeln
- 21/514 Hartmetallwerkzeuge
- 21/521 Schnitt- und Stanzwerkzeuge
- 21/522 Schneidstempel
- 21/532 Werkzeuge für Ritzmaschinen
- 21/541 Presswerkzeuge zur Multilayerherstellung
- 21/542 Spezialbeschichtete Pressbleche
- 21/543 Reparatur und Aufarbeitungsservice für Presswerkzeuge
- 21/551 Sonstige Werkzeuge
- 21/562 Werkzeugbau
- 21/563 Werkzeuge für Kantenfräsmaschinen

21/600 Resiste, Lötstopplacke, Farben, Lacke, Kleber

- 21/611 Fotoresiste
- 21/612 Siebdruck-, Ätz- und Galvanoresiste
- 21/613 Elektrophoretische Resiste
- 21/614 UV-Lacke
- 21/615 Ink-Jet
- 21/621 Fotosensible Festresistlötstoppmasken
- 21/622 Fotosensible Flüssiglötstoppmasken
- 21/623 Lötstopplacke für den Siebdruck
- 21/624 Abziehbare Lötstoppmasken
- 21/631 Fotolacke für die Mikroelektronik

- 21/641 Lacke und Schutzlacke
- 21/642 Leitleber und Leitlecke
- 21/643 Gießharze und Vergussmassen
- 21/644 Klebstoffe für SMDs
- 21/645 Wärmeleitprodukte
- 21/646 Silikone
- 21/647 Silberpaste für Solarzellen

21/700 Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Hilfsprodukte für den Siebdruck

- 21/711 Kopierlampen
- 21/721 Materialien zur Schablonenherstellung
- 21/722 SMT-Metallschablonen-Spannsysteme
- 21/741 Siebdruckfolien
- 21/742 Siebgewebe
- 21/751 Siebspannungsmessgeräte
- 21/752 Maschenzähler
- 21/753 Entfettungsmittel
- 21/754 Transportbänder

21/800 Verpackungen

- 21/811 Versand- und Verpackungsmaterialien
- 21/812 ESD-Versand- und Verpackungsmaterial
- 21/813 ESD-Arbeitsplatzausrüstung (Einrichtung und Tisch-/Bodenbeläge)
- 21/814 ESD-Personenerdung (Kleidung/Schuhe/Erdungssystem)
- 21/815 ESD-Reinigung
- 21/816 ESD-Lager- und Transporteinrichtungen

21/900 Verfahren

- 21/911 Rückätzverfahren
- 21/918 Bleifreie Zinnlegierungen
- 21/921 Durchkontaktierungsverfahren
- 21/931 Ätzverfahren
- 21/941 Galvanoverfahren
- 21/951 Verfahren zur Haftungssteigerung bei der Multilayerherstellung
- 21/961 Spezialverfahren für Lötstoppmasken
- 21/971 Spezialverfahren zur Leiterplattenproduktion
- 21/981 Abwasserbehandlungsverfahren
- 21/991 Recycling-Verfahren
- 21/992 Direktmetallisierung
- 21/993 Heißprägen von MID (Molded Interconnect Devices)
- 21/994 Zinnstripp-Verfahren
- 21/995 Reinigungsverfahren
- 21/996 Reinraumtechnik

22 Bearbeitungsmaschinen- und -anlagen für die Leiterplattenfertigung

22/100 Galvanik

22/110 Anlagen

- 22/111 Anlagen für die Leiterplattengalvanik
- 22/112 Galvanoautomaten
- 22/113 Anlagen für die selektive Galvanisierung
- 22/114 Pulse-plating-Anlagen
- 22/120 Horizontale Durchkontaktierungsanlagen

22/150 Anlagenzubehör

- 22/151 Steuerungen
- 22/152 Stromversorgungen
- 22/153 Gleichrichter
- 22/154 Amperestunden- und Metallmengenähler
- 22/156 Anodenkörbe
- 22/157 Galvanogestelle
- 22/158 Badwärmer
- 22/159 Gleichrichtersteuerung
- 22/160 Halarbeschichtungen
- 22/161 I/O-Systeme für Steuerungen
- 22/162 Leiterplattengestelle

22/200 Nassprozess, Produktions- und Prozesstechnik

22/210 Anlagen

- 22/211 Ätzanlagen und -maschinen
- 22/212 Chemische Behandlungsanlagen
- 22/213 Schwarioxidieranlagen
- 22/214 Etch-back-Desmearing-Anlagen
- 22/215 Plasma-Ätzanlagen
- 22/216 Reinigungsanlagen und -maschinen, Waschanlagen
- 22/217 Bimsmehlprühmaschinen
- 22/218 Bürstmaschinen, Entgratungsanlagen
- 22/221 Entwicklungsanlagen und -maschinen
- 22/222 Strippanlagen und -maschinen
- 22/223 Metallstrippanlagen und -maschinen
- 22/224 Tintenstrahl-Kennzeichnungsdrucker
- 22/225 Tintenstrahl-Lötstopplackdrucker
- 22/235 Trockner allgemein
- 22/236 Vakuum-Temper-Anlagen
- 22/241 Heißluftverzinnungsanlagen
- 22/242 Heißölverzinnungsanlagen
- 22/243 Umschmelzanlagen
- 22/244 Walzverzinnungsanlagen
- 22/245 Flussmittel-Auftragsanlagen
- 22/246 Bearbeitungsanlagen für Dickschicht-, Hybrid-, SM-Technik
- 22/247 Selektiv-Lackieranlagen
- 22/248 Gelier- und Aushärtenanlagen
- 22/249 Sonderanlagen und -maschinen

22/250 Produktions- und prozesstechnisches Zubehör

- 22/251 Temperaturmess- und Regelgeräte
- 22/252 Temperaturfühler
- 22/253 Kunststoffpumpen
- 22/254 Chemikalienpumpen
- 22/255 Fass- und Behälterpumpen
- 22/256 Tauchpumpen
- 22/257 Dosierpumpen
- 22/258 Filterpumpen
- 22/260 Automatische Dosiergeräte, -einrichtungen
- 22/261 Dosiergeräte, -einrichtungen
- 22/264 Füllstandsüberwachung, Niveauregelung
- 22/265 pH-, Leitfähigkeits-, Stromdichte-Regelung
- 22/266 Photometrische Dosiersteuergeräte
- 22/271 Kunststoffbehälter - Tanklager
- 22/281 Reparatursysteme für unbestückte Leiterplatten
- 22/291 Schläuche, Rohrleitungen aus Kunststoff (Zubehörteile)
- 22/292 Trennverstärker
- 22/293 Wärmetauscher

22/300 Fototechnik, Siebdruck

22/310 Fototechnische Anlagen und Zubehör

- 22/311 Belichtungsgeräte
- 22/312 Direktbelichtungssysteme
- 22/313 UV-Lampen
- 22/321 Gießmaschinen
- 22/322 Laminatoren, Beschichtungsgeräte
- 22/323 Walzbeschichtungsmaschinen
- 22/325 Elektrostatische Lötstopplack-Beschichtungsanlagen
- 22/326 Sprayer für photosensitiven Lötstopplack
- 22/327 Doppelseitige Vertikalbeschichtungsanlagen für Fotolötstopplacke
- 22/331 Schutzfilm-Entfernungsautomaten für Fotoresiste
- 22/332 Trocknungsanlagen
- 22/341 Fototechnisches Zubehör
- 22/342 Registriersysteme
- 22/345 Durchlaufhärtenanlagen für Lötstopplack
- 22/346 LDI-Equipment (Geräte zur Laser-Direktbelichtung)
- 22/347 Vertikaler Rollcoater
- 22/348 Automatische Viskositätsregelanlagen für Lacke
- 22/349 Vacuum Via Hole Filling für Bohrungen und Sacklochbohrungen

22/350 Siebdruckanlagen und -zubehör

- 22/352 Siebelichtungseinrichtungen
- 22/361 Siebdruckmaschinen
- 22/362 Siebdruckanlagen für Kleberauftrag
- 22/363 Siebdruckanlagen für Lötpastenauftrag
- 22/364 Siebdruckanlagen für die Hybridtechnik
- 22/371 Siebwaschanlagen
- 22/373 Siebentschichtungsanlagen
- 22/374 Siebspannapparate
- 22/375 Siebtrockenanlagen
- 22/376 UV-Trocknungsanlagen
- 22/378 Drucksiebe
- 22/379 Siebrahmen

22/400 Mechanik

- 22/411 Bohr- und Fräsmaschinen
- 22/413 Röntgenbohrmaschinen
- 22/414 CNC-Maschinen für die LP-Prototypenfertigung
- 22/415 Bohrschleifmaschinen
- 22/416 Ringsetzmaschinen für Bohrer und Fräser
- 22/418 Bohrprogrammiereinrichtungen
- 22/421 Materialstanzen
- 22/422 Stanzmaschinen
- 22/431 Ritzmaschinen
- 22/432 Kantenfräsmaschinen
- 22/433 CNC-Multilayer-Besäummaschinen
- 22/441 Sägen, vollautomatische Sägen
- 22/442 Präzisionssägen
- 22/451 Tafelscheren, Schlagscheren
- 22/461 Ver-/Entstifter
- 22/471 Entstaubungsanlagen
- 22/481 Folien-Schneidegeräte
- 22/483 Laser-Bohrmaschinen
- 22/484 Längs-/Querschneider für Prepregs

22/500 Multilayeraufbau

- 22/511 Multilayerpressen
- 22/521 Multilayerlegeplätze

- 22/531 Referenzsysteme, Registriertsysteme
- 22/532 Prepreg Dispenser

22/600 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Recycling

22/610 Wasseraufbereitung

- 22/611 Wasserenthärtungsanlagen
- 22/612 Wasservollentsalzungsanlagen
- 22/613 Anlagen zur Rein- und Reinstwasserherstellung
- 22/614 Wasserentkeimung
- 22/615 Umkehrosmoseanlagen

22/620 Abwassertechnik

- 22/621 Abwasseranlagen
- 22/622 Reaktoren zur Abwasserentgiftung und Neutralisierung
- 22/623 Kammerfilterpressen
- 22/624 Dekanter, Schräg- und Schnellklärer
- 22/625 Sedimentationsbehälter, -becken und -anlagen
- 22/626 Schwermetallentfernung aus Abwasser
- 22/627 Abwasserreinigung mit Ultrafiltration/Mikrofiltration
- 22/628 Elektrolytische Oxidation

22/630 Recycling

- 22/631 Elektrolyseanlagen zur Metallrückgewinnung
- 22/632 Lösungsmittel-Rückgewinnungsanlagen
- 22/633 Verdunstungs- und Vakuumverdampfungsanlagen zur Elektrolytrückführung
- 22/634 Ultrafiltrationsanlagen
- 22/635 Umkehrosmose-Anlagen
- 22/636 Elektrodialyseanlagen
- 22/637 Anlagen zur Rückgewinnung von Ätzlösungen
- 22/638 Destillieranlagen
- 22/639 Rückgewinnung wässriger Reinigungsmittel
- 22/640 Edelmetall-Rückgewinnungsgeräte
- 22/641 Mikrofiltrationsanlagen

22/650 Luft- und Klimatechnik

- 22/651 Abluftreiniger
- 22/652 Absauganlagen
- 22/653 Zuluftreinigungssysteme
- 22/655 Klimatechnik
- 22/656 Anlagen für Reinraumtechnik
- 22/659 Gaswäscher, abwasserfrei

22/700 DV-Anlagen und Systeme

- 22/711 PPS-Systeme
- 22/721 BDE-Systeme
- 22/722 Zugangskontroll-Systeme
- 22/731 CAQ-Systeme
- 22/732 CAQ-Systeme für den Leiterplatten-Testbereich
- 22/741 DNC-Systeme
- 22/750 Automatisierungs-Software
- 22/751 CAD-Anlagen und Software
- 22/752 CAM-Anlagen und Software
- 22/753 CNC-Programmierplätze
- 22/755 Kalkulations-Software
- 22/756 Leiterplatten-Entwicklungssysteme
- 22/757 CIM- und CAM-Datenarchivierungssoftware
- 22/758 CAE-Software
- 22/759 CAD-Software

- 22/760 CNC-Steuerungen für LP-Bearbeitungsmaschinen
- 22/761 Badmanagement-Software
- 22/770 Netzwerke (Hard- und Software)
- 22/780 Betriebswirtschaftliche Software
- 22/782 Instandhaltung Management-Software

22/800 Handling, Transport, Lagerung, Verpackung und Versand

- 22/811 Zustapler
- 22/812 Abstapler
- 22/813 Handlinggeräte
- 22/814 Wendevorrichtungen
- 22/821 Transportstraßen
- 22/822 Transportsysteme
- 22/823 Transportkörbe
- 22/824 Transportwagen
- 22/825 Transportsystem ESD-gerecht
- 22/841 Transport- und Lackiergestelle
- 22/872 Pufferstationen

22/900 Plasma-Technik

- 22/997 Plasmaätzen
- 22/998 Plasmareinigen

23 Kontroll- und Prüfeinrichtungen

23/100 Analytik

- 23/111 Kolorimeter und Photometer
- 23/112 UV-Messgeräte
- 23/113 pH-Meter
- 23/116 Geräte zur CSB- und AOX-Bestimmung im Abwasser
- 23/118 Leitfähigkeitsmessgeräte
- 23/121 Kontrollgeräte für Betriebswässer
- 23/161 Automatische Überwachungsgeräte für chem. Bäder
- 23/165 Badanalytik-Software
- 23/175 Online-Analysatoren
- 23/176 Online-Titratoren
- 23/177 Prozessanalytoren

23/200 Qualitätsüberwachungssysteme, Metallographie, Schichtdicken und -aufbauten

- 23/211 Optische Mikroskope
- 23/221 Schichtdickenmessgeräte
- 23/223 Röntgenfluoreszenzmessgeräte
- 23/232 Ultraschallreinigungsanlagen und Zubehör
- 23/234 Filteranlagen und Filtriergeräte
- 23/242 Geräte zur Messung von Abzieh- und Ausreißfestigkeiten
- 23/260 Geräte zur Schlifferstellung
- 23/275 Lötbarkeitstester
- 23/280 Temperatur- und Klimakammern
- 23/281 Stress-Screening-Systeme

23/300 Visuelle/optische Prüfung

- 23/311 Optische Inspektionsgeräte für Wafer und SMT
- 23/312 Optische Kontrollgeräte

- 23/313 Automatisch-optische Inspektionsgeräte
- 23/314 Prüftische, Leuchtische
- 23/315 Lupen
- 23/316 Lupenleuchten
- 23/320 Geräte für die Oberflächenprüfung
- 23/330 Geräte für die Röntgenprüfung von Multilayern
- 23/331 Röntgeninspektionssysteme
- 23/333 Digitale Röntgenlaminographie
- 23/340 Optische In-Line-Chip-Prüfung
- 23/350 SPC-Software/Repair-Systeme

23/400 Elektronik, elektrische Messgeräte

- 23/411 Elektrische Prüfautomaten
- 23/412 Prüfadapter
- 23/413 Geräte zur Herstellung von Prüfadaptern
- 23/420 Impedanzmesssysteme
- 23/421 Verbindungstester
- 23/422 Kurzschlusslokalisiergeräte
- 23/430 Funktionstester
- 23/431 Testsysteme für digitale und analoge Baugruppen
- 23/432 Reparatursysteme für unbestückte Leiterplatten
- 23/435 ICT-Handler
- 23/441 Elektronische Tester für Axial- und DIP-Komponenten
- 23/451 Federkontaktstifte und Testzubehör
- 23/452 Starrstifte
- 23/453 Tera- und Megohmmeter und Zubehör
- 23/454 Hochspannungsprüfgeräte und Zubehör
- 23/455 Anlagen zum Abgleich und Justage von elektrischen Schaltungen
- 23/456 Boundary Scan

23/600 Prüfbühnen

- 23/610 Fehlerkennzeichnung, selbstklebend
- 23/620 Testhandler

23/700 Labormittel, Laborverbrauchsprodukte

- 23/722 Laborkleingeräte, Laborausstattung

23/800 Qualitätssicherung

- 23/811 Zertifiziert nach DIN ISO 9001 (EN 29001, ISO 9001, 2008)
- 23/812 Zertifiziert nach DIN ISO 9002 (EN 29002)
- 23/814 UL-Zulassung
- 23/815 Zertifiziert nach QS 9000
- 23/816 MIL-Zulassung
- 23/817 ESA-Zulassung
- 23/819 Sonstige Zulassungen _____

23/900 Diverse Messgeräte

- 23/911 Koordinatenmesstische
- 23/912 Testsysteme für Innenlagerversatz
- 23/922 Ritztiefmessgeräte
- 23/923 Bohrer-Durchmesser-Messgeräte
- 23/925 Maßstäbe
- 23/932 Geräte zur Spindel-Rundlauf-Messung
- 23/941 Oberflächenmessgeräte
- 23/942 Computertomographen
- 23/971 Thermometer
- 23/982 Doppelplatten-Detektor
- 23/986 Filmflächenmessgeräte
- 23/990 Härtemessgeräte

- 23/995 Messgeräte für div. Spindelprüfungen
- 23/996 Klima- und Umwelttest

24 Einrichtungen und Materialien zur Unterlagensbearbeitung, Konstruktion und Entwicklung

24/100 Hilfsmittel zur Unterlagensbearbeitung

- 24/113 Folien- und Klebmaterial
- 24/116 Plotterfolien

24/200 Geräte zur Unterlagensbearbeitung

- 24/214 Inkjet-Drucker
- 24/215 Laserplotter
- 24/216 Photoplotter
- 24/235 Kopierautomaten
- 24/241 Film-Registrierstanzen
- 24/251 Film-Entwicklungsmaschinen
- 24/262 Glasdruck-Einschübe

24/300 Filme und Fotomaterialien

- 24/311 Silberfilme
- 24/312 Diazofilme
- 24/313 Glasmaster
- 24/314 Reprofilme
- 24/315 Trockenfilme
- 24/321 Entwicklerchemikalien
- 24/331 Fotopapier
- 24/332 Schutzfilme für Filmvorlagen

24/900 Fotolaborzubehör

- 24/910 Weißlicht-UV-Filterlampen
- 24/950 Filmschneider
- 24/961 Möbel und Leuchtische
- 24/962 Film-, Metallschablonen-Lagersysteme
- 24/963 Filterfolien für Fenster und Röhren
- 24/964 Reinigungsprodukte

25 Anlagen, Einrichtungen, Geräte, Maschinen für die Weiterverarbeitung von Leiterplatten

25/100 Vorbereitung

- 25/111 Bauteil-Vorbereitungsmaschinen
- 25/121 Schneidemaschinen (Cutter)
- 25/131 Programmierplätze für Bestückungsautomaten und -tische
- 25/141 Bauteil-Zählgeräte
- 25/142 Tisch- und Standfluxgeräte

25/200 Bestückung

- 25/211 Bestückungsautomaten
- 25/212 Bestückungshalbautomaten
- 25/221 SMD-Bestückungsautomaten
- 25/222 SMD-Halbautomaten
- 25/231 Bestückungseinrichtungen
- 25/241 Bestückungstische

- 25/251 Chip-Bestückungsautomaten
- 25/261 Dosiergeräte für Kleber
- 25/262 Bondanlagen
- 25/263 Flip-Chip-Bonder
- 25/264 Leiterplattenaktivierung
- 25/265 Zuführsystem für Bauelemente
- 25/267 Dosierautomaten
- 25/268 Underfill-Dispenser, autom.
- 25/269 Glob-Top-Dispenser, autom.
- 25/270 Aushärtesystem für Materialien mit höchster Qualität
- 25/271 SMD-Gurtverbinder

25/300 Verbindungstechnik

- 25/311 Lötanlagen
- 25/312 Lötanlagen für SMD-Technik
- 25/313 Vakuumlötanlagen
- 25/314 Lötstationen
- 25/315 Selektive Lötanlagen
- 25/316 Wellenlötanlagen
- 25/322 Reparatur-Lötgeräte für SMDs
- 25/323 Entlötgeräte
- 25/331 Schweißgeräte für die Elektronik
- 25/332 Mikroschweißgeräte, Bonder
- 25/333 Widerstandsschweißelektroden
- 25/351 Leiterplattenverdrahtungsverfahren
- 25/352 Wire-Wrap-Verdrahtungswerkzeuge
- 25/353 Einpresstechnik
- 25/354 Lötroboter
- 25/361 Kabelbearbeitungsmaschinen
- 25/371 Montageeinrichtungen
- 25/381 Transport- und Handling-Einrichtungen
- 25/391 Waschanlagen
- 25/392 Lötdampfabsorber
- 25/395 Lötstellenkontrollgeräte
- 25/396 Lötparameter-Messsysteme
- 25/397 Einpressautomatensysteme

25/400 Zubehör

- 25/411 Klein-Elektrowerkzeuge
- 25/412 Elektroschrauber/Akkuschrauber
- 25/423 Lötzubehör (Lötdrähte, Lötformteile, Reiniger)
- 25/424 Lötspitzenreiniger
- 25/425 Lötpasten-Auftragsschablonen
- 25/426 Lötrahmen
- 25/427 Lötmasken
- 25/428 Entlötlitze

25/800 Weiterverarbeitung von Flachbaugruppen

- 25/810 Weiterverarbeitung von Flachbaugruppen
- 25/811 Lackieranlagen für Flachbaugruppen
- 25/812 Selektive Lackieranlagen für Flachbaugruppen
- 25/813 Anlagen zum Markieren und Beschriften mit Laser
- 25/814 Anlagen zum Markieren und Beschriften
- 25/815 Schablonen-Spannsysteme
- 25/816 Trennvorrichtung für bestückte Leiterplatten
- 25/817 Schutzbeschichtungsanlagen für Elektronikbaugruppen
- 25/820 Nutzentrennmaschinen
- 25/821 Reparatursysteme für bestückte Leiterplatten
- 25/830 Entmontage Automaten
- 25/835 Reparatursysteme für Flachbaugruppen
- 25/840 Automatische Verpackungsanlagen
- 25/850 Reinraumkabinen
- 25/860 Einbrennöfen

- 25/861 Trockner allgemein im Bereich Bg- und Lp-Technik
- 25/862 Tauchlackieranlagen
- 25/863 Gelier- und Aushärteanlagen
- 25/870 Laser-Trimmer

25/900 Verschiedenes

- 25/911 Bauelemente, Bauteile
- 25/912 Anschlussklemmen
- 25/913 Steckverbindungen, Griffe, Halter, IC-Sockel, Klemmen
- 25/914 Steckverbinder zum Einlöten in Leiterplatten
- 25/921 Antistatikeinrichtungen
- 25/922 Geräte zur Teileverfolgung mittels Barcode
- 25/923 Geräte zur Teileverfolgung mittels OCR-Identifikation
- 25/924 Geräte zur Beschriftungsprüfung bei Bauteilen
- 25/925 Geräte zur optischen Verlötlungsprüfung
- 25/932 EPROM-Löschgeräte
- 25/934 HF- und Mikrowellenmessgeräte
- 25/951 Tastaturen
- 25/961 Netzteile
- 25/962 Transformatoren nach Kundenwunsch
- 25/963 Wickelgüterherstellung
- 25/971 Mess- und Regeltechnik
- 25/981 Verpackung, Transport- und Lagerverpackungen
- 25/982 Steckverbinder zum Einpressen in Leiterplatten
- 25/983 Prüfsysteme für Busplatinen
- 25/984 Isolierfolien
- 25/985 Frequenzumrichter für HF-Spindeln
- 25/990 Heißsiegelanlagen

30 Dienstleistungen

30/300 Leiterplattenproduktion

- 30/311 Bohren von Leiterplatten
- 30/312 Fräsen von Leiterplatten
- 30/313 Ritzen unbestückter Leiterplatten
- 30/314 Stanzen von Leiterplatten
- 30/321 Lohngalvanisieren von Leiterplatten
- 30/322 Partielles Vergolden von Leiterplatten
- 30/331 Optische Kontrolle von Leiterplatten
- 30/332 AOI-Prüfung von Leiterplatten
- 30/333 Elektrische Prüfung von Leiterplatten
- 30/334 Prüfadapterbau
- 30/335 Entwicklung von Prüfadaptern
- 30/341 Masslamination
- 30/351 Hot Air Leveling
- 30/361 Lohnbedrucken
- 30/381 Reparatur von Bohrspindeln
- 30/382 Beschichten von Walzen
- 30/383 Nachschleifen von Bohrern
- 30/386 Lohnbeschichtung chemisch Zinn
- 30/387 Zuschneideservice für verschiedene Materialien
- 30/388 Chemische Nickel/Gold-Beschichtung
- 30/389 Galvanisieren von Bauteilen
- 30/390 Reinigung von Leiterplatten
- 30/391 CAM-Datenaufbereitung, Fotoplot, Scannen

30/400 Laboruntersuchungen, Prüfungen

- 30/411 Abwasseruntersuchungen
- 30/412 Analytische Badüberwachung
- 30/415 Leitfähigkeitsmessungen
- 30/421 Metallografische Untersuchungen

Zulieferer und Dienstleister

- 30/422 Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen
- 30/431 Physikalische Laboruntersuchungen
- 30/432 Leiterplattenprüfung nach DIN IEC 249
- 30/433 Durchstrahlungsprüfungen
- 30/434 Vibrationstests
- 30/435 Computertomographie
- 30/441 Maßprüfungen
- 30/451 Maschinen- und Prozessfähigkeitsuntersuchungen

30/500 Sonstige Produktionsprozesse

- 30/512 Formätzteile
- 30/513 Metallschablonen, lasergeschnitten
- 30/516 Kunststoffschablonen, lasergeschnitten
- 30/517 Laserstrukturieren von Fotoresist/Lötstoppmasken
- 30/518 Flexible SMT-Kunststoffschablonen

30/600 Servicedienstleistungen

- 30/610 Feinauswuchten von Bohrspindeln
- 30/611 Schneidbleche für THT-Bauteile
- 30/620 Reinraumkleidung im Mietservice
- 30/630 Modernisierung/Umbau von CNC-Steuerungen
- 30/640 CAD-Layout
- 30/650 Kabelkonfektionierung

30/700 Recycling

- 30/710 Recycling von Basismaterial
- 30/711 Recycling von Bohrauflagen
- 30/712 Recycling von Bürststaub
- 30/713 Recycling von verbrauchten Anoden
- 30/714 Recycling von verbrauchten CU-Folien
- 30/715 Recycling von verbrauchten Bohrern und Fräsern
- 30/716 Recycling von Galvanikschlamm
- 30/717 Recycling von Leiterplattenschrott
- 30/718 Recycling von Rückständen aus der Leiterplattenproduktion
- 30/719 Regeneration von Metallen und metallhaltigen Lösungen
- 30/720 Recycling von Ätzlösungen
- 30/721 Recycling von Bohr-Frässtaub
- 30/722 Recycling von Edelmetallen und Edelmetalllösungen

30/800 Fachmessen, Ausstellungen, Brancheninformationen

- 30/811 Brancheninformationen
- 30/812 Fachverlage/Fachliteratur
- 30/813 Fachmessen/Fachausstellungen

30/900 Verschiedenes

- 30/911 Dickfilmtechnik
- 30/912 Herstellung von Etiketten, Typenschildern, Frontplatten
- 30/913 Etiketten
- 30/914 Codierer
- 30/915 Stanzen, Nibbeln und Prägen von Folien
- 30/916 Schablonenservice
- 30/917 Maschinen- und Anlagenservice
- 30/918 Lackierservice für Flachbaugruppen
- 30/919 Kunststoffschweißerei
- 30/920 Vakuum-Lagerschränke
- 30/921 Reparatur von Leiterplatten
- 30/922 Lasern von Folien
- 30/923 Vakuumpinzetten
- 30/924 Hand- und Fingerschutz
- 30/925 Pressbleche aus Aluminium oder Stahl

- 30/926 Interconnect-Stress-Test nach IPC-TM650
- 30/927 Coating mit bleifreiem Lack
- 30/928 Zuverlässigkeitsprüfung von bleifreien Lötverbindungen
- 30/929 OSP-Beschichtung
- 30/930 Reparatur von Testautomaten
- 30/931 Folien für Druck- und Temperaturmessung
- 30/941 Schulung von Personal
- 30/942 Trainingskurse für die Leiterplattentechnologie
- 30/943 Schulung CAD-CAM-EMV-Software
- 30/945 Schweißseminare
- 30/951 Technische Werbung
- 30/952 Dokumentation
- 30/954 Internet-Werbung
- 30/955 Leasing
- 30/957 Aus- und Weiterbildungen/Schulungen
- 30/958 Beratung Testtechnologie
- 30/959 Beratung für neue Leiterplattentechnologien
- 30/960 Beratung Kostenreduzierung elektronischer Geräte
- 30/961 Qualitätsmanagement-Beratung
- 30/962 EDV-Beratung
- 30/963 Technologische Beratung
- 30/964 Projektierung, Projektberatung
- 30/965 Beratung in Umwelttechnik
- 30/966 Wasserrechtsverfahren
- 30/967 Gutachten
- 30/968 Recycling-Technologien
- 30/969 Durchführung von Umwelt-Audits
- 30/970 Beratung/Support bei Outsourcing
- 30/971 Gebrauchtmaschinen
- 30/972 Leiterplattenbeschaffung
- 30/975 Datenübertragung analog/ISDN
- 30/976 Mailbox-Service
- 30/977 Beratung Molded Interconnect Devices (MID)
- 30/978 Leiterplattensimulation
- 30/979 Thermische Simulation
- 30/980 Messe- und Kongressorganisation
- 30/990 Zertifizierung von Qualitätsmanagement-Systemen
- 30/991 Zertifizierung von Umwelt-Management-Systemen
- 30/992 Zertifizierung von QM-System-Auditoren
- 30/993 Zertifizierung von Öko-Gutachtern
- 30/994 Schulungen und Kurse
- 30/995 Durchführung von QMS-Audits
- 30/996 Durchführung von Produkt-Audits
- 30/997 Durchführung von Prozess-Audits
- 30/998 Durchführung von Lieferanten-Audits
- 30/999 Service für Chemisch-Silber-Abscheidung

Neue Rubriken
